

# トップUBPプロセス

## TOP UBP PROCESS

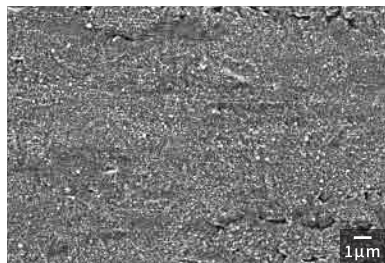
- 純アルミニウム, アルミニウム合金スパッタ膜へのめっきプロセス  
Plating process for aluminum- and aluminum-alloy sputtering layer
- アルミニウム電極とめっき皮膜間の密着性に優れる  
High adhesion performance between aluminum electrodes and plating films
- 熱処理後においても耐クラック性に優れる  
high-crack resistance even after heat treatment

### 処理工程 Process



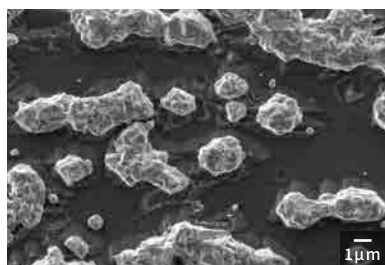
### 緻密なジンケート析出 Deposit fine zincate films

2<sup>nd</sup> ジンケート後の表面SEM外観 (Al-Si電極上)  
SEM image of Al-Si electrode surface (after 2<sup>nd</sup> zincate)



観察倍率  
Magnification  
x5000

トップUBPプロセス TOP UBP PROCESS



一般品 General products

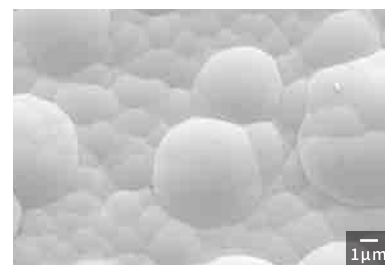
### めっき平滑性に優れる前処理 Pre-treatment: can obtain smooth films

無電解ニッケルめっき後の表面SEM外観 (Al-Si電極上)  
SEM image of Al-Si electrode surface (after electroless nickel plating)



観察倍率  
Magnification  
x5000

トップUBPプロセス TOP UBP PROCESS



一般品 General products